

2025-2030年中国半导体设备行业市场需求前景与投资规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——

第1章：半导体设备行业概念界定及发展环境剖析

1.1 半导体设备的概念界定及统计口径说明

1.1.1 半导体及半导体设备界定

- 1、半导体
- 2、半导体设备的概念界定

1.1.2 半导体设备的分类

1.2 半导体设备专业术语说明

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

- 1.4.1 本报告权威数据来源
- 1.4.2 本报告研究方法及统计标准说明

——现状篇——

第2章：中国半导体设备行业宏观环境分析（PEST）

2.1 半导体设备行业政策环境分析

2.1.1 行业监管体系及机构

- 1、中国半导体设备产业主管部门
- 2、中国半导体设备产业自律组织

2.1.2 行业规范标准体系建设现状

- 1、中国半导体设备产业标准体系建设
- 2、中国半导体设备产业相关标准统计

2.1.3 行业发展相关政策汇总及解读

2.1.4 十四五规划对半导体设备产业发展的影响

- 1、集成电路政策红利为半导体设备保驾护航
- 2、“十四五”规划加速半导体设备国产化进程

2.1.5 政策环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.2 半导体设备行业经济环境分析

2.2.1 宏观经济现状

- 1、中国GDP及增长情况
- 2、中国工业经济增长情况
- 3、中国生产者价格指数（PPI）
- 4、中国固定资产投资分析

2.2.2 宏观经济展望

- 1、国际机构对中国GDP增速预测
- 2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 经济环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.3 半导体设备行业社会环境分析

2.3.1 中国人口规模及城镇化水平

- 1、中国人口规模及增速
- 2、中国城镇化水平变化

2.3.2 中国电子信息产业发展

- 1、电子信息制造业发展现状分析
- 2、电子信息行业前景与趋势分析
 - （1）信息技术创新进入新一轮加速期
 - （2）国家重大战略推进实施亟待产业新突破
 - （3）智能化正成为电子信息产业的重要发展趋势

2.3.3 研发经费投入增长

2.3.4 其他相关社会因素

- 1、集成电路严重依赖进口
- 2、消费电子近年持续增长

2.3.5 社会环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.4 半导体设备行业技术环境分析

- 2.4.1 半导体行业技术迭代历程
- 2.4.2 存储芯片制程演进
 - 1、存储芯片结构演变
 - 2、对半导体设备的影响
- 2.4.3 半导体工艺技术路径朝多种路径3D化发展
- 2.4.4 相关专利的申请情况分析
 - 1、半导体设备专利申请数情况
 - 2、半导体设备行业专利申请人分析
 - 3、半导体设备行业热门申请专利分析
- 2.4.5 半导体设备行业技术发展趋势
- 2.4.6 技术环境对半导体设备行业发展的影响分析

2.5 半导体设备行业发展机遇与挑战

第3章：半导体行业发展及半导体设备的地位分析

3.1 全球半导体行业发展分析

- 3.1.1 全球半导体行业发展现状概述
- 3.1.2 全球半导体行业市场规模
- 3.1.3 全球半导体行业产品结构分析
- 3.1.4 全球半导体行业区域发展分析
- 3.1.5 全球半导体行业发展趋势分析

3.2 中国半导体行业发展分析

- 3.2.1 半导体行业整体发展情况
 - 1、市场规模
 - 2、市场结构
 - 3、应用领域
- 3.2.2 半导体设计业发展
 - 1、半导体设计业市场规模
 - 2、半导体设计业企业格局
 - 3、半导体设计业区域竞争
 - 4、半导体设计业市场结构
- 3.2.3 半导体制造业发展
 - 1、半导体制造业生产情况
 - 2、半导体制造业市场规模
 - 3、半导体制造业企业竞争
 - 4、半导体制造业区域竞争
- 3.2.4 半导体封装测试业发展
 - 1、半导体封装测试业市场规模
 - 2、半导体封测业区域竞争
 - 3、半导体封测业企业竞争
- 3.2.5 中国半导体行业发展趋势分析
 - 1、中国半导体行业发展趋势
 - (1) 战略性新兴产业将加速发展
 - (2) 资本市场将为企业融资提供更多机会
 - (3) “双循环”加速国产替代
 - (4) 5G新兴技术带来新一轮爆发
 - 2、中国半导体行业发展前景预测
- 3.2.6 半导体设备在半导体行业中的位置

3.3 半导体设备对半导体行业发展的影响分析

第4章：全球半导体设备行业发展现状及趋势前景分析

4.1 全球半导体设备行业发展现状分析

- 4.1.1 全球半导体设备行业发展历程
- 4.1.2 全球半导体设备行业发展现状
 - 1、市场规模
 - 2、市场结构
 - 3、细分产品结构
- 4.1.3 全球半导体设备行业竞争格局分析
 - 1、区域竞争
 - 2、品牌竞争

4.2 全球主要区域半导体设备行业发展现状分析

- 4.2.1 全球半导体产业转移状况
 - 4.2.2 韩国半导体设备行业发展分析
 - 1、韩国半导体行业发展情况
 - 2、韩国半导体设备行业发展情况
 - (1) 韩国半导体设备市场发展现状
 - (2) 韩国半导体设备市场发展趋势
 - 4.2.3 北美半导体设备行业发展分析
 - 1、北美半导体行业发展情况
 - 2、北美半导体设备行业发展情况
 - (1) 北美半导体设备市场发展现状
 - (2) 北美半导体设备市场发展趋势
 - 4.2.4 日本半导体设备行业发展分析
 - 1、日本半导体行业发展情况
 - 2、日本半导体设备行业发展情况
 - (1) 日本半导体设备市场发展现状
 - (2) 日本半导体设备市场发展趋势
 - 4.3 全球半导体设备主要企业发展分析**
 - 4.3.1 应用材料 (Applied Materials, Inc.)
 - 1、企业基本情况介绍
 - 2、企业经营情况分析
 - 3、企业半导体设备业务发展情况
 - 4、企业在华业务布局
 - 4.3.2 泛林半导体 (Lam Research)
 - 1、企业基本情况介绍
 - 2、企业经营情况分析
 - 3、企业半导体设备业务发展情况
 - 4、企业在华业务布局
 - 4.3.3 荷兰ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography)
 - 1、企业基本情况介绍
 - 2、企业经营情况分析
 - 3、企业半导体设备业务发展情况
 - 4、企业在华业务布局
 - 4.3.4 东京电子 (TEL)
 - 1、企业基本情况介绍
 - 2、企业经营情况分析
 - 3、企业半导体设备业务发展情况
 - 4、企业在华业务布局
 - 4.4 全球半导体设备行业发展趋势及经验借鉴**
 - 4.4.1 全球半导体设备行业发展趋势分析
 - 4.4.2 全球半导体设备行业发展的经验借鉴
- 第5章：中国半导体设备行业发展现状分析**
- 5.1 中国半导体设备行业发展概述**
 - 5.1.1 半导体设备行业发展历程分析
 - 5.1.2 半导体设备行业市场特征分析
 - 5.2 中国半导体设备行业进出口市场分析**
 - 5.2.1 中国半导体设备行业进口市场分析
 - 1、进口额分析
 - 2、进口来源国分析
 - 5.2.2 中国半导体设备行业出口市场分析
 - 1、出口额分析
 - 2、出口来源国分析
 - 5.3 半导体设备行业国产化进程分析**
 - 5.3.1 半导体设备行业国产化进程
 - 1、行业整体国产化进程
 - 2、行业细分领域国产化进程
 - 5.3.2 厂商突破新领域加速推进国产化进程
 - 5.4 中国半导体设备行业在全球地位分析**
 - 5.4.1 半导体设备行业市场规模分析
 - 5.4.2 中国半导体设备市场规模占全球比重

- 5.5 中国半导体设备市场供需状况分析
 - 5.5.1 中国半导体设备参与者类型及规模
 - 1、中国半导体设备参与者类型
 - 2、中国半导体设备参与者规模
 - 5.5.2 中国半导体设备供给情况
 - 5.5.3 中国半导体设备需求状况
 - 5.6 中国台湾地区半导体设备行业发展分析
 - 5.6.1 中国台湾地区半导体行业发展情况
 - 1、中国台湾地区半导体产业规模
 - 2、中国台湾地区半导体产业特征
 - 5.6.2 中国台湾地区半导体设备行业发展情况
 - 5.7 中国半导体设备行业发展痛点分析
- 第6章：半导体设备行业竞争状态及竞争格局分析**
- 6.1 半导体设备行业投资、兼并与重组分析
 - 6.1.1 行业融资现状
 - 1、投融资资金来源
 - 2、投融资主体分析
 - 3、投融资事件数量及金额分布
 - 4、投融资阶段及事件汇总
 - 6.1.2 行业兼并与重组
 - 1、兼并与重组现状
 - 2、兼并与重组动因分析
 - 6.2 半导体设备行业波特五力模型分析
 - 6.2.1 现有竞争者之间的竞争
 - 6.2.2 行业潜在进入者威胁
 - 6.2.3 行业替代品威胁分析
 - 6.2.4 行业供应商议价能力分析
 - 6.2.5 行业购买者议价能力分析
 - 6.2.6 行业竞争情况总结
 - 6.3 中国半导体设备行业企业竞争格局分析
 - 6.4 中国半导体设备行业全球竞争力分析
- 第7章：中国半导体设备行业细分市场分析**
- 7.1 中国半导体设备行业构成分析
 - 7.2 中国半导体薄膜沉积设备行业发展分析
 - 7.2.1 半导体薄膜沉积工艺概述
 - 7.2.2 半导体薄膜沉积技术发展分析
 - 1、CVD技术工艺
 - 2、PVD技术
 - 3、ALD技术
 - 7.2.3 半导体薄膜沉积设备发展现状分析
 - 1、半导体薄膜沉积设备市场规模分析
 - 2、半导体薄膜沉积设备国产化现状
 - 7.2.4 半导体薄膜沉积设备发展趋势分析
 - 7.3 中国半导体光刻设备行业发展分析
 - 7.3.1 半导体光刻工艺概述
 - 7.3.2 半导体光刻技术发展分析
 - 1、光刻技术原理
 - 2、光学光刻技术
 - 3、EUV光刻技术
 - 4、X射线光刻技术
 - 5、纳米压印光刻技术
 - 7.3.3 半导体光刻机发展现状分析
 - 1、光刻机工作原理
 - 2、光刻机发展历程
 - 3、光刻机市场规模
 - 4、光刻机国产化现状
 - 7.3.4 半导体光刻设备发展趋势分析
 - 7.4 中国半导体刻蚀设备行业发展分析
 - 7.4.1 半导体刻蚀工艺概述

- 7.4.2 半导体刻蚀工艺发展情况
 - 1、主要刻蚀工艺分类
 - 2、刻蚀工艺演进现状
- 7.4.3 半导体刻蚀设备发展现状分析
 - 1、刻蚀设备市场规模
 - 2、刻蚀机国产化现状
- 7.4.4 半导体刻蚀设备发展趋势分析

7.5 中国半导体清洗设备行业发展分析

- 7.5.1 半导体清洗工艺概述
- 7.5.2 半导体清洗技术发展分析
 - 1、半导体清洗技术分类
 - 2、半导体清洗技术——湿法清洗
 - 3、半导体清洗技术——干法清洗
- 7.5.3 半导体清洗设备发展现状分析
 - 1、半导体清洗设备分类
 - 2、半导体清洗设备市场规模
 - 3、半导体清洗设备国产化现状
- 7.5.4 半导体清洗设备发展趋势分析

7.6 中国半导体封装设备行业发展分析

- 7.6.1 半导体封装工艺概述
- 7.6.2 半导体封装技术发展分析
- 7.6.3 半导体封装设备发展现状分析
- 7.6.4 半导体封装设备发展趋势分析

7.7 中国半导体测试设备行业发展分析

- 7.7.1 半导体测试工艺概述
- 7.7.2 半导体测试技术发展分析
- 7.7.3 半导体测试设备发展现状分析
 - 1、半导体测试设备分类
 - 2、半导体测试设备国产化现状
- 7.7.4 半导体测试设备发展趋势分析
 - 1、5G、汽车和物联网需求推动测试设备需求增长
 - 2、国产化进程进一步加快

7.8 中国半导体制造其他设备发展分析

- 7.8.1 单晶炉设备
 - 1、设备简介
 - 2、生产工艺
 - 3、单晶炉投料情况
 - 4、国内代表厂商情况
- 7.8.2 氧化/扩散/热处理设备
 - 1、设备简介
 - 2、国内代表厂商情况
 - 3、国产替代情况
- 7.8.3 离子注入设备
 - 1、设备简介
 - (1) 设备定义
 - (2) 设备原理
 - (3) 设备分类
 - 2、国内代表厂商情况
 - 3、国产替代情况

第8章：中国半导体设备行业领先企业生产经营分析

8.1 半导体设备行业代表企业概况

8.2 半导体设备行业代表性企业案例分析

- 8.2.1 北方华创科技集团股份有限公司
 - 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 公司发展历程
 - (2) 公司基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - (1) 主要经济指标分析
 - (2) 企业盈利能力分析

- 3、企业业务结构及销售网络
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 企业半导体设备产品布局
 - (2) 企业研发投入情况
 - 5、企业半导体设备战略布局及最新发展动态
 - (1) 企业半导体设备战略布局
 - (2) 企业最新发展动态
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.2 中微半导体设备（上海）股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 公司发展历程
 - (2) 公司基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - (1) 主要经济指标分析
 - (2) 企业盈利能力分析
 - 3、企业业务结构及销售网络
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 企业半导体设备产品布局
 - (2) 企业半导体设备项目布局
 - (3) 企业半导体设备技术进展
 - 5、企业半导体设备战略布局及最新发展动态
 - (1) 企业半导体设备战略布局
 - (2) 企业最新发展动态
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.3 拓荆科技股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 公司发展历程
 - (2) 公司基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业销售网络分析
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - 5、企业融资历程
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.4 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
- 1、企业基本信息简介
 - (1) 公司基本信息
 - (2) 公司股权结构
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构及主要客群
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 前道晶圆制造半导体设备
 - (2) 后道先进封装半导体设备
 - (3) 清洗设备介绍
 - (4) 其他半导体设备介绍
 - 5、企业半导体设备战略布局及最新发展动态
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.5 上海至纯洁净系统科技股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 企业发展历程
 - (2) 企业基本信息
 - 2、企业经营状况分析

- 3、企业业务结构及销售网络
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - 5、企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.6 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 企业发展历程
 - (2) 企业基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构及销售网络
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 企业半导体设备产品布局
 - (2) 企业半导体设备技术进展
 - 5、企业半导体设备业务“专精特新”布局动向
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.7 北京屹唐半导体科技有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 公司发展历程
 - (2) 公司基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业融资历程
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 业务布局
 - (2) 产品布局
 - 5、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.8 上海微电子装备（集团）股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 公司发展历程
 - (2) 公司基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - (1) 中标情况
 - (2) 荣誉资质
 - 3、企业业务结构
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 前道半导体设备
 - (2) 后道封装半导体设备
 - 5、企业融资历程
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.9 中国电子科技集团有限公司
- 1、企业发展基本信息及组织架构
 - (1) 企业基本信息
 - (2) 企业组织架构
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构及销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - 5、企业半导体设备战略布局
 - 6、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.10 北京华卓精科科技股份有限公司
- 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 企业发展历程
 - (2) 企业基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 企业半导体设备产品布局

- (2) 企业半导体设备关键技术
- (3) 企业半导体设备产业化布局
- 5、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.11 北京华峰测控技术股份有限公司
 - 1、企业基本信息简介
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构及销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 半导体设备产品经营情况
 - (2) 半导体设备研发情况
 - 5、企业发展半导体设备业务的优劣势分析
- 8.2.12 杭州长川科技股份有限公司
 - 1、企业发展历程及基本信息
 - (1) 企业发展历程
 - (2) 企业基本信息
 - 2、企业经营状况分析
 - 3、企业业务结构及销售网络
 - (1) 业务结构
 - (2) 销售网络
 - 4、企业半导体设备业务布局
 - (1) 企业半导体设备产品布局
 - (2) 企业半导体设备技术进展
 - 5、企业半导体设备相关产销状况
 - 6、企业半导体设备业务研发动向
 - 7、企业发展半导体设备业务的优劣势分析

——展望篇——

第9章：中国半导体设备行业发展前景预测与投资机会分析

- 9.1 半导体设备行业投资潜力分析
 - 9.1.1 行业生命周期分析
 - 9.1.2 行业发展潜力分析
- 9.2 半导体设备行业发展前景预测
 - 9.2.1 半导体设备行业发展趋势
 - 9.2.2 半导体设备行业发展前景预测
- 9.3 半导体设备行业投资特性分析
 - 9.3.1 行业进入壁垒分析
 - 9.3.2 行业投资风险预警
- 9.4 半导体设备行业投资价值与投资机会
 - 9.4.1 行业投资价值分析
 - 9.4.2 行业投资机会分析
- 9.5 半导体设备行业投资策略与可持续发展建议
 - 9.5.1 行业投资策略分析
 - 9.5.2 行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1：半导体分类结构
- 图表2：半导体与集成电路、芯片的关系图
- 图表3：半导体分类简介
- 图表4：半导体设备在芯片制造产业链中的位置及范围
- 图表5：半导体设备的分类
- 图表6：半导体设备专业术语说明
- 图表7：本报告研究范围界定
- 图表8：本报告权威数据资料来源汇总
- 图表9：本报告的主要研究方法及统计标准说明
- 图表10：中国半导体设备行业监管体系
- 图表11：中国半导体设备产业主管部门

- 图表12: 中国半导体设备产业自律组织
- 图表13: 截至2024年中国半导体设备产业标准体系建设 (单位: 项)
- 图表14: 截至2024年中国半导体设备行业相关标准汇总
- 图表15: 截至2024年中国半导体设备行业发展政策汇总及解读
- 图表16: 政策环境对半导体设备产业发展的影响总结
- 图表17: 2011-2024年中国国内生产总值及其增速 (单位: 万亿元, %)
- 图表18: 2011-2024年中国全部工业增加值及增速 (单位: 万亿元, %)
- 图表19: 2020-2024年中国PPI变化情况 (单位: %)
- 图表20: 2011-2024年中国固定资产投资额 (不含农户) 及增速 (单位: 万亿元, %)
- 图表21: 部分国际机构对2023年中国GDP增速的预测 (单位: %)
- 图表22: 2018-2024年中国GDP与半导体设备行业营收规模相关性
- 图表23: 2012-2024年中国人口规模及自然增长率 (单位: 万人, ‰)
- 图表24: 2012-2024年中国城镇人口规模及城镇化率 (单位: 万人, %)
- 图表25: 2021-2024年电子信息制造业累计增加值和累计出口交货值增速 (单位: %)
- 图表26: 2021-2024年电子信息制造业营业收入、利润增速变动情况 (单位: %)
- 图表27: 2021-2024年电子信息制造业固定资产投资增速变动情况 (单位: %)
- 图表28: 2017-2024年中国研究与试验发展 (R&D) 经费投入及增速情况 (单位: 亿元, %)
- 图表29: 2017-2024年中国研究与试验发展 (R&D) 经费投入强度 (与GDP之比) 情况 (单位: %)
- 图表30: 2018-2024年中国集成电路行业进口贸易规模和进口数量 (单位: 亿美元, 亿个)
- 图表31: 2020-2024年中国手机网民规模情况 (单位: 亿人)
- 图表32: 社会环境对半导体设备行业发展的影响总结
- 图表33: 半导体行业技术迭代历程 (单位: nm, 层)
- 图表34: 存储芯片结构演变
- 图表35: 2Xnm DRAM对比28nm逻辑电路制程前道加工步骤增量
- 图表36: 半导体工艺技术多种路径3D化
- 图表37: 2005-2024年中国半导体设备行业相关专利申请数量 (单位: 项, %)
- 图表38: 截至2024年中国半导体设备相关技术专利申请人构成TOP10 (单位: 件)
- 图表39: 截至2024年中国半导体设备相关技术专利申请TOP10 (单位: 项, %)
- 图表40: 中国半导体设备行业技术发展趋势
- 图表41: 技术环境对中国半导体设备行业发展的影响分析
- 图表42: 中国半导体设备行业发展机遇与挑战分析
- 图表43: 全球半导体产业发展脉络
- 图表44: 2011-2024年全球半导体产业市场规模-按销售额 (单位: 亿美元, %)
- 图表45: 2017-2024年全球半导体行业细分市场结构 (单位: 亿美元)
- 图表46: 2024年全球半导体行业地区分布 (单位: %)
- 图表47: 2025-2030年全球半导体应用领域年均增长率预测 (单位: 亿美元, %)
- 图表48: 2016-2024年中国半导体产业销售额及其增长情况 (单位: 亿美元, %)
- 图表49: 2011-2024年中国集成电路行业销售额 (单位: 亿元, %)
- 图表50: 2011-2024年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况 (单位: %)
- 图表51: 2024年中国半导体行业应用领域结构排名
- 图表52: 2011-2024年中国集成电路设计业销售额和增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表53: 2024年中国芯片设计公司TOP10 (Fabless+IDM)
- 图表54: 2021-2024年中国集成电路设计业销售额区域分布 (单位: %)
- 图表55: 2021-2024年中国集成电路设计业城市销售额TOP10 (单位: 亿元)
- 图表56: 2024年中国集成电路设计业产品应用领域情况 (单位: %)
- 图表57: 2010-2024年中国集成电路产量及增速 (单位: 亿块, %)
- 图表58: 2011-2024年中国集成电路制造业销售额和增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表59: 2024年中国IC制造企业TOP10
- 图表60: 2020-2024年中国集成电路产量区域分布 (单位: 亿块)
- 图表61: 2011-2024年中国集成电路封装测试业销售额及增长情况 (单位: 亿元, %)
- 图表62: 截至2024年中国集成电路封装测试业企业区域分布情况 (单位: %)
- 图表63: 2024年中国IC封测企业TOP10
- 图表64: 2025-2030年中国半导体行业市场规模预测 (单位: 亿美元)
- 图表65: 半导体设备在半导体生产过程中的应用情况
- 图表66: 半导体行业倒三角框架
- 图表67: 全球半导体设备行业发展历程
- 图表68: 2015-2024年全球半导体设备行业销售额 (单位: 亿美元, %)
- 图表69: 2024年全球半导体设备市场结构 (单位: %)
- 图表70: 2024年全球半导体设备细分产品结构 (单位: %)

- 图表71: 2015-2024年全球半导体设备行业地区分布情况 (单位: %)
- 图表72: 2024年全球半导体设备供应商TOP10 (单位: 亿美元)
- 图表73: 全球半导体产业迁移路径图及迁移结构
- 图表74: 韩国半导体产业的投入情况
- 图表75: 2020-2024年韩国半导体设备销售额 (单位: 亿美元)
- 图表76: 2025-2030年韩国半导体设备销售额预测 (单位: 亿美元)
- 图表77: 北美地区主要半导体设备制造企业基本情况 (单位: 百万美元)
- 图表78: 2020-2024年北美半导体设备销售额 (单位: 亿美元)
- 图表79: 2025-2030年北美半导体设备销售额预测 (单位: 亿美元)
- 图表80: 日本半导体产业发展历程
- 图表81: 日本主要半导体设备制造企业基本情况
- 图表82: 2020-2024年日本半导体设备销售额 (单位: 亿美元)
- 图表83: 2025-2030年日本半导体设备销售额预测 (单位: 亿美元)
- 图表84: 应用材料公司基本信息表
- 图表85: 2017-2024年财年应用材料公司经营情况 (单位: 亿美元)
- 图表86: 应用材料公司半导体设备业务产品线结构
- 图表87: 泛林半导体公司基本信息表
- 图表88: 2017-2024年财年泛林半导体公司经营情况 (单位: 亿美元)
- 图表89: 泛林半导体公司半导体设备类型
- 图表90: 泛林半导体公司半导体设备产品系列介绍
- 图表91: 荷兰ASML公司基本信息表
- 图表92: 2018-2024年荷兰ASML公司经营情况 (单位: 亿欧元)
- 图表93: 荷兰ASML公司半导体设备主要产品介绍
- 图表94: 东京电子公司基本信息表
- 图表95: 2017-2024年财年东京电子公司经营情况 (单位: 亿日元)
- 图表96: 东京电子公司半导体设备主要产品
- 图表97: 东京电子公司在华布局
- 图表98: 2025-2030年全球半导体设备行业市场规模预测-按销售额 (单位: 亿美元)
- 图表99: 全球半导体设备行业发展的经验借鉴
- 图表100: 中国半导体设备行业发展历程
- 图表101: 中国半导体设备行业发展特征
- 图表102: 2020-2024年中国半导体设备行业进口额分析 (单位: 亿美元, %)
- 图表103: 2024年中国半导体设备行业进口主要国家或地区 (单位: 亿美元, %)
- 图表104: 2020-2024年中国半导体设备行业出口额分析 (单位: 亿美元, %)
- 图表105: 2024年中国半导体设备行业出口主要国家或地区 (单位: 亿美元)
- 图表106: 2018-2024年国产半导体设备销售额及国产化率变化 (单位: 亿元, %)
- 图表107: 2024年中国半导体设备行业细分领域国产化替代情况 (单位: 亿元, %)
- 图表108: 本土半导体设备企业在多个环节先进制程领域产业化进展加速
- 图表109: 2018-2024年中国大陆半导体设备市场规模分析 (单位: 亿美元)
- 图表110: 2015-2024年中国大陆半导体设备市场规模占全球比重情况 (单位: %)
- 图表111: 中国半导体设备行业市场主体类型构成
- 图表112: 截至2024年中国半导体设备行业新注册企业数量 (单位: 家)
- 图表113: 中国半导体设备行业代表性企业
- 图表114: 2024年中国半导体设备中标情况 (单位: 项)
- 图表115: 2018-2024年中国台湾半导体行业产值及预测 (单位: 亿美元)
- 图表116: 中国台湾半导体产业特征
- 图表117: 2017-2024年中国台湾半导体设备销售额 (单位: 亿美元)
- 图表118: 中国半导体设备行业发展痛点分析
- 图表119: 半导体设备行业资金来源分析
- 图表120: 中国半导体设备行业投融资主体分析
- 略...完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！